



## Intel® Core™ i5-6500TE Processor

6M Cache, up to 3.30 GHz

### Niezbędne zasoby

- Kolekcja produktów [6th Generation Intel® Core™ i5 Processors](#)
- Nazwa kodowa [Nazwa Skylake poprzednich produktów](#)
- Segment rynku pionowego Embedded
- Numer procesora i5-6500TE
- Stan Launched
- Data rozpoczęcia Q4'15
- Litografia 14 nm
- Rekomendowana cena klienta \$192.00
- Warunki użytkowania Embedded Broad Market Commercial Temp, PC/Client/Tablet

### Wydajność

- Liczba rdzeni 4
- Liczba wątków 4
- Bazowa częstotliwość procesora 2,30 GHz
- Maks. częstotliwość turbo 3,30 GHz
- Cache 6 MB SmartCache
- Szybkość magistrali 8 GT/s DMI3
- TDP 35 W

### Informacje uzupełniające

- Dostępne opcje rozwiązań wbudowanych Tak
- Dane katalogowe [Wyświetl teraz](#)

### Dane techniczne pamięci

- Maks. wielkość pamięci (w zależności od rodzaju pamięci) 64 GB
- Rodzaje pamięci DDR4-1866/2133, DDR3L-1333/1600 @ 1.35V
- Maks. liczba kanałów pamięci 2
- Maks. przepustowość pamięci 34,1 GB/s
- Obsługa pamięci ECC † Nie

### Grafika wbudowana w procesor

- Układ graficzny procesora † Intel® HD Graphics 530
- Częstotliwość podstawowa układu graficznego 350 MHz
- Maks. częstotliwość dynamiczna układu graficznego 1,00 GHz
- Maks. pamięć wideo układu graficznego 64 GB
- Wyjście do grafiki eDP/DP/HDMI/DVI

- Obsługa 4K Yes, at 60Hz
- Maks. rozdzielczość (HDMI 1.4)‡ 4096x2304@24Hz
- Maks. rozdzielczość (DP)‡ 4096x2304@60Hz
- Maks. rozdzielczość (eDP – wbudowany płaski wyświetlacz)‡ 4096x2304@60Hz
- Maks. rozdzielczość (VGA)‡ N/A
- Obsługa DirectX\* 12
- Obsługa OpenGL\* 4.5
- Intel® Quick Sync Video Tak
- Technologia Intel® InTru™ 3D Tak
- Technologia Intel® Clear Video HD Tak
- Technologia Intel® Clear Video Tak
- Liczba obsługiwanych wyświetlaczy † 3
- Identyfikator urządzenia 0x1912

## Opcje rozszerzeń

- Skalowalność 1S Only
- Wersja PCI Express 3.0
- Liczba konfiguracji PCI Express † Up to 1x16, 2x8, 1x8+2x4
- Maksymalna liczba linii PCI Express 16

## Specyfikacja obudowy

- Obsługiwane gniazda FCLGA1151
- Maks. konfiguracja procesora 1
- Specyfikacja systemu Thermal Solution PCG 2015A (35W)
- Wymiary obudowy 37.5mm x 37.5mm

## Technologie zaawansowane

- Technologia Intel® Turbo Boost † 2.0
- Intel® vPro™ — kryteria kwalifikowalności platformy † Tak
- Technologia Intel® Hyper-Threading † Nie
- Technologia Intel® Virtualization (VT-x) † Tak
- Technologia Intel® Virtualization for Directed I/O (VT-d) † Tak
- Technologia Intel® VT-x with Extended Page Tables (EPT) † Tak
- Intel® TSX-NI Tak
- Intel® 64 † Tak
- Zestaw instrukcji 64-bit
- Rozszerzony zestaw instrukcji Intel® SSE4.1, Intel® SSE4.2, Intel® AVX2
- Stany bezczynności Tak
- Udoskonalona technologia Intel SpeedStep® Tak
- Technologie monitorowania chłodzenia Tak
- Technologia Intel® ochrony tożsamości † Tak
- Program stabilnych platform firmy Intel® ułatwiających pracę administratorom Tak

## Niezawodność i bezpieczeństwo

- Intel® AES New Instructions Tak
- Secure Key Tak
- Intel® Software Guard Extensions (Intel®SGX) Tak
- Intel® Memory Protection Extensions (Intel® MPX) Tak
- Intel® OS Guard Tak

- Technologia Intel® Trusted Execution † Tak
- Funkcje Execute Disable Bit † Tak
- Intel® Boot Guard Tak